

第35回マイクロエレクトロニクスシンポジウム2025



MES2025 論文・展示募集

開催日・講演発表日：2025年9月3日(水)～5日(金)

開催会場：大阪大学中之島センター（大阪市）&オンライン開催

発表・展示申込期間：2025年4月下旬～6月13日(金)

論文提出期間：2025年6月25日(水)～7月22日(火)

交流会：2025年9月4日(木) 18時開始予定

交流会会場：レストランアラスカ フェスティバルタワー

≪MES2025ホームページ≫ * 詳細および最新の情報はここからご参照ください

<https://jiep.or.jp/event/mes/mes2025/>



1. 一般発表

口頭発表 または ポスター発表

募集論文：エレクトロニクス実装に関する広範な技術・研究論文

- 1) 先端プロセス・実装技術（配線板、インターポーザ、積層技術、チップレット、ハイブリッドボンディングなど）
- 2) パワーエレクトロニクス実装技術（パワーデバイス実装、サーマルマネジメント、高熱伝導材料、耐熱材料など）
- 3) 高速高周波実装・電磁特性技術（電源回路、高速伝送線路、アンテナ、ワイヤレス給電、人体通信、EMC、ミリ波など）
- 4) マイクロメカトロニクス実装技術（MEMS、封止パッケージ、常温接合、センサ・アクチュエータなど）
- 5) 光回路実装技術（光インタコネクション、CPO、光モジュール、シリコンフォトニクスなど）
- 6) プリントブル・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス
（アディティブマニュファクチャリング、バイオセンサ、生体適合性材料など）
- 7) 環境調和型エレクトロニクス（グリーンエネルギー、蓄電池、光電変換、環境調和型実装材料など）
- 8) 信頼性技術（熱応力、機械疲労、マイグレーション、寿命予測など）
- 9) シミュレーション・計算機による評価・設計
（AI活用、機械学習、熱応力解析、疲労解析、回路シミュレーションなど）
- 10) めっき技術（配線形成、スルーホールめっき、高密着技術、表面処理など）
- 11) 最先端材料（配線材料、接合材料、基板材料、ナノマテリアル、メタマテリアルなど）
- 12) その他

マイクロエレクトロニクスシンポジウム2025 (MES2025)

2. 企業展示 展示スペース、プレゼンテーション、バナー広告、広告掲載

- ① 展示スペース（企業PR可能：机180cm×60cm,椅子,ボード90cm×118cm,電源）
- ② コアタイムセッション（1時間予定）
- ③ 企業プレゼンテーション（1社10分ほど）
- ④ バナー広告（MES2025ホームページ：会社ロゴ掲載・URLリンク）
- ⑤ 予稿集への広告掲載（MES2025予稿集の広告掲載）
- ⑥ 交流会参加費 1名無料（企業展示申込1社につき1名参加無料）
- ⑦ 聴講・予稿データダウンロード可能（企業展示申込1社につき1名参加無料）
- ⑧ 説明補助員追加登録特権（展示やプレゼンテーションの説明補助員の追加特権）

参加費一覧

聴講・参加、オンライン視聴、予稿データダウンロード含む (消費税込み)

発表者・聴講者(参加者)		参加登録期間	早期 参加費 2025年7月31日迄	通常 参加費 2025年8月1日～9月5日迄
参加(聴講)者	会員	正会員	15,000円	17,000円
		海外会員	15,000円	17,000円
		若手会員	15,000円	17,000円
		シニア会員	7,000円	9,000円
		学生会員	3,500円	4,000円
		名誉会員	無料	
口頭発表者	賛助会員	賛助会員	15,000円	17,000円
		クーポン	使用可（無料）	
ポスター発表者	共催会員	一般	15,000円	17,000円
		学生*	3,500円	4,000円
	協賛会員	一般	20,000円	22,000円
		学生*	4,500円	5,000円
	非会員	一般	28,000円	30,000円
		学生*	5,500円	6,000円

*学生はいずれも交流会参加費込

オプション	交流会参加費(先着160名)	6,000円
	予稿集冊子版(国内発送のみ)	4,000円

企業展示(企業セッション)		参加登録期間	参加登録費 2025年6月13日迄	特権
企業展示	会員	正会員	80,000円	・企業展示スペース ・プレゼンテーション ・バナー広告（ロゴ掲載・リンクURL） ・予稿集広告掲載 ・交流会参加費 ・聴講費 ・予稿データダウンロード
		共催会員		
		賛助会員		
	非会員	協賛会員	100,000円	
		一般	130,000円	
企業展示登録後	補助員	1名につき ※	15,000円	交流会参加無料、聴講可能

※参加者氏名にて登録ください（複数名参加は人数分の登録が必要です）

【協賛団体】予定

IEEE EPS Japan Chapter,映像情報メディア学会,応用物理学会,化学工学会,関西サイエンス・フォーラム, KEC関西電子工業振興センター, 高分子学会, 精密工学会, 電気化学会, 電気学会, 電子情報技術産業協会, 電子情報通信学会, 日本機械学会, 日本セラミックス協会, 日本電子回路工業会, 日本電子材料技術協会, 日本ロボット工業会, 光産業技術振興協会, 表面技術協会, 溶接学会, 粉体粉末冶金協会

主催：一般社団法人 エレクトロニクス実装学会
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2
お問合せMail：E-mail: mes2025@jiep.or.jp
ホームページ: <https://jiep.or.jp>



共催
予定

大阪大学接合科学研究所

